



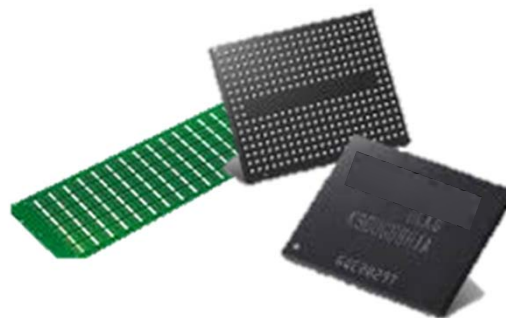
대덕전자 소개

대덕PCB
History

회사소개

제품설명

진공관 라디오, 흑백 TV부터 반도체, 스마트폰 까지 한국의 전자산업과 함께해온 대덕

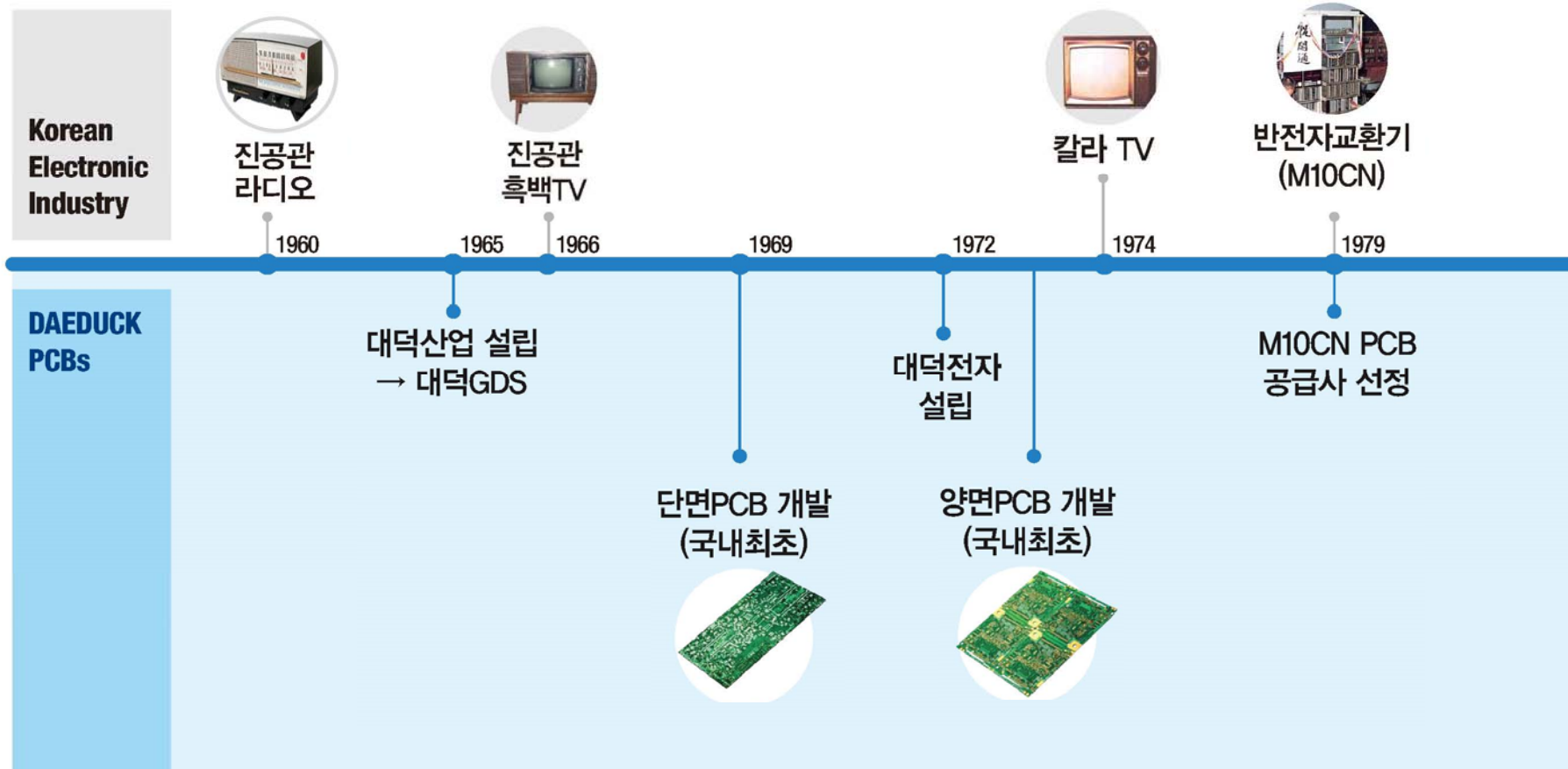


대덕PCB
History

회사소개

제품설명

✓ 1960~70년대 <사업 초석>

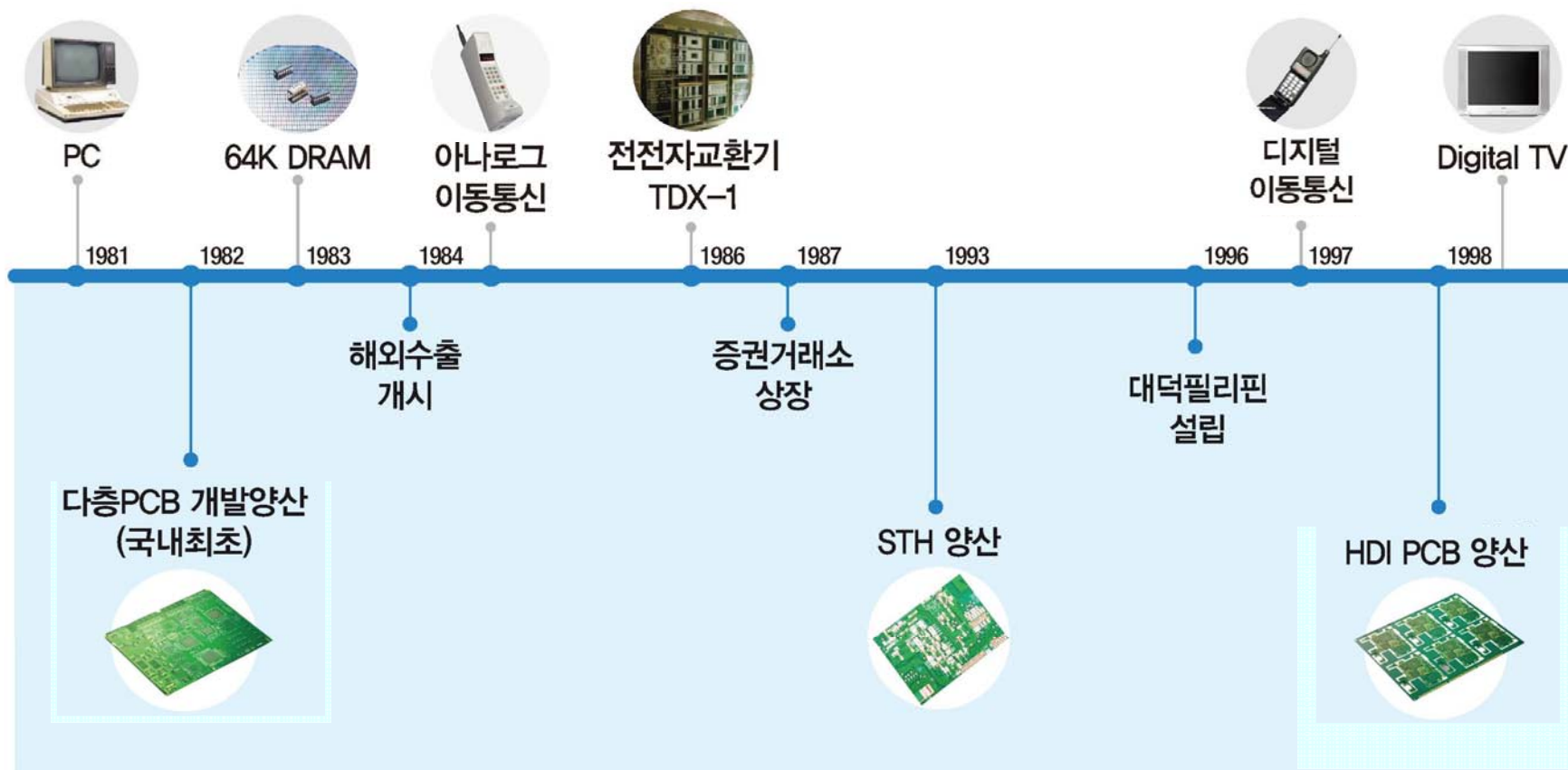


대덕PCB
History

회사소개

제품설명

✓ 1980~90년대 <수출과 성장>

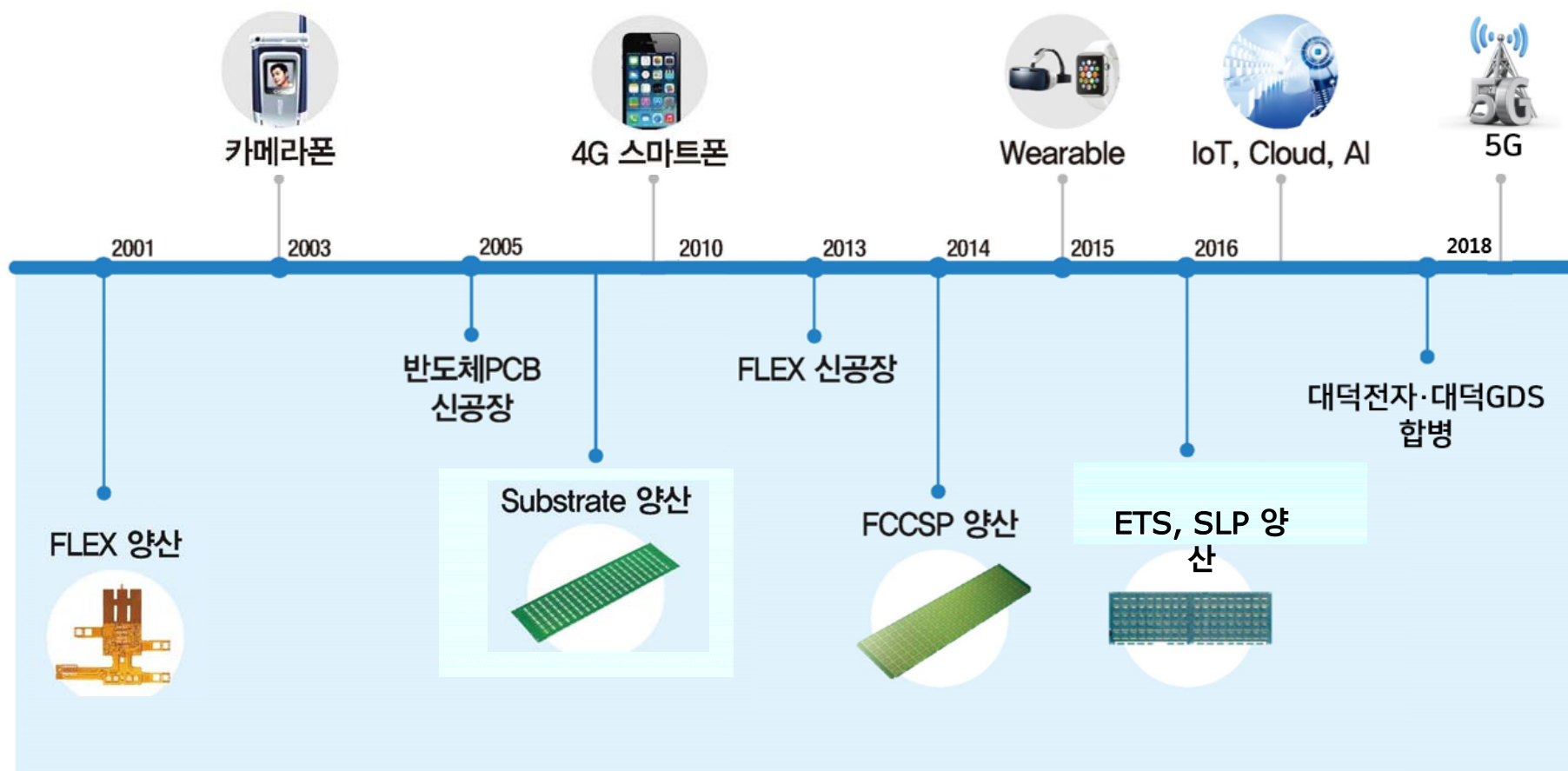


대덕PCB
History

회사소개

제품설명

✓ 2000~10년대 <모바일/반도체 집중>



대덕PCB
History

회사소개

제품설명

✓ 회사 프로필 및 연혁



- **PKG부문**
경기도 시흥시 시화공단



- **MLB부문**
경기도 안산시 반월공단



- **Mobile부문/관리부문**
경기도 안산시 반월공단

- 매출 : 9,600억(`18년)
- 자산 : 1조 1,000억원
(`18년)
- 인원 : 2,000여명(`18년)
- 업종 : 제조업(인쇄회로기판)

- 1965 : 대덕GDS 설립
- 1972 : 대덕전자 설립
- 1987 : 대덕GDS 증권거래소 상장
- 1989 : 대덕전자 증권거래소 상장
- 1999 : 금탑산업훈장 수상
- 2001 : 포브스誌 선정 "세계200대 중소기업"
- 2003 : 경제정의기업대상
- 2012 : 산자부 세계일류상품 인증(빌드업기판)
- 2013 : 6억달러 수출탑 수상
- 2014 : 통계의 날 대통령 표창
- 2015 : 동반성장 최우수 협력기업상
- 2016 : 삼성전자 Best Partner Award 수상

대덕PCB
History

회사소개

제품설명

Global Network



대덕PCB
History

회사소개

제품설명

✓ 기업의 사회적 책임

지역사회
환원



대덕어린이 집



대덕과학탐구학습관



명휘원 해동일터

과학인재
후원



해동상 제정



학습시설 지원



장학사업

대덕PCB
History

회사소개

제품설명

✓ 사원 복지

사원들의 삶의 질 향상을 위해 다양한 복지제도 운영

주거지원

- 주택구입자금 대출
- 기숙사 · 사택 운영

건강 관리

- 종합건강검진(배우자 포함)
- 단체상해보험, 의료비 지원

DAEDUCK

교육비(학자금) 지원

- 직원교육비 (외국어, 자기계발 지원)
- 자녀학자금 (유치원, 학원, 중고등학교, 대학교)

기타(여가 · 생활)

- 동호회 지원, 콘도 운영
- 명절 선물지급, 귀향 교통편의 지원

대덕PCB
History

회사소개

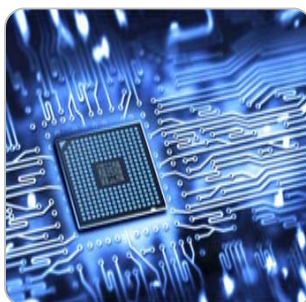
제품설명



PCB Portfolio

상
품

반도체



스마트폰



네트워크/자동차



P
C
B

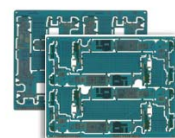
Ultra Thin
CSP



S I P



FCCSP



MSAP HDI



High Density
FPC



5G Module
High Layer MLB



Radar
Module



Infotainment



Probe card

대덕PCB
History

회사소개

제품설명

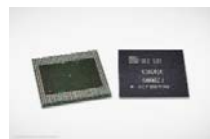
포트폴리오

반도체

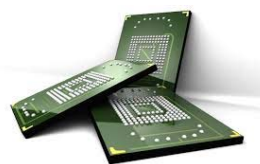
메모리



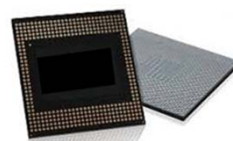
비메모리



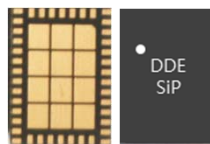
Mobile DRAM



Nand Flash

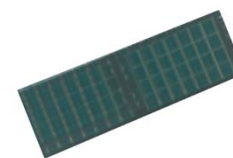


Application Processor



RF Module

Ultra Thin CSP



- 초박판 패키지 기판
2층 70 μ m, 3층/80 μ m
- 두께공차 +/- 7 μ m
- Warpage 제어

CSP



- 2층 구조 / 두께 90 μ m
- 3층 구조 / 두께 100 μ m
- 4층 구조 / 두께 140 μ m

FC CSP



- 층 구조 2~4층
Line/Space 10/10 μ m

SiP / Module



- Coreless Any Layer

대덕PCB
History

회사소개

제품설명

포트폴리오

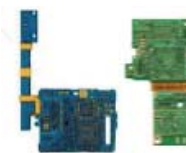
스마트폰



High Density FPC



Wearable Board



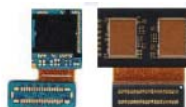
- 고밀도 연성기판



OLED / camera Module



Cavity & Flat
Rigid Flex

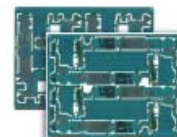


- cavity 타입의 연성기판
- 표면 평탄화 기술
(Flatness < 25 μ m)



Mobile main Board

HDI

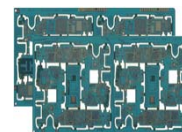


- 다양한 구조의
스마트폰 메인보드
(Stack Via, Any Layer)



High-end Main Board

SLP



- mSAP 적용 메인기판
Line/Space 20 μ m/20 μ m

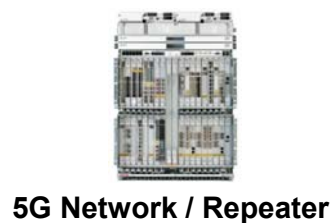
대덕PCB
History

회사소개

제품설명

포트폴리오

네트워크/자동차



5G Module
High Layer MLB

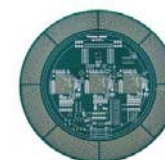


- Cored 10~12층 Full 스택비어
- OSP + SOP
- 20층 이상 고다층 기판
- Back Drill



Wafer Tester

Probe Card



- 80층 이상의 초 고다층 기판
- High Aspect Ratio (37:1)



AVN, Telematics

Infotainment



- 고신뢰 / 고밀도 기판
- 회로폭 < 50μm



Sensor for Automotive

Radar Module



- 고주파 대응
- 테프론 등 Low Dk 원재료



전자산업발전에
기여하는
혁신기업

사람과 기술을
함께 키워갑니다